



各位

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（アップデート）

詳細につきましては、添付資料「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（アップデート）」をご参照ください。

以上

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応（アップデート）

2026年8月6日

ステラケミファ株式会社

（証券コード：4109）

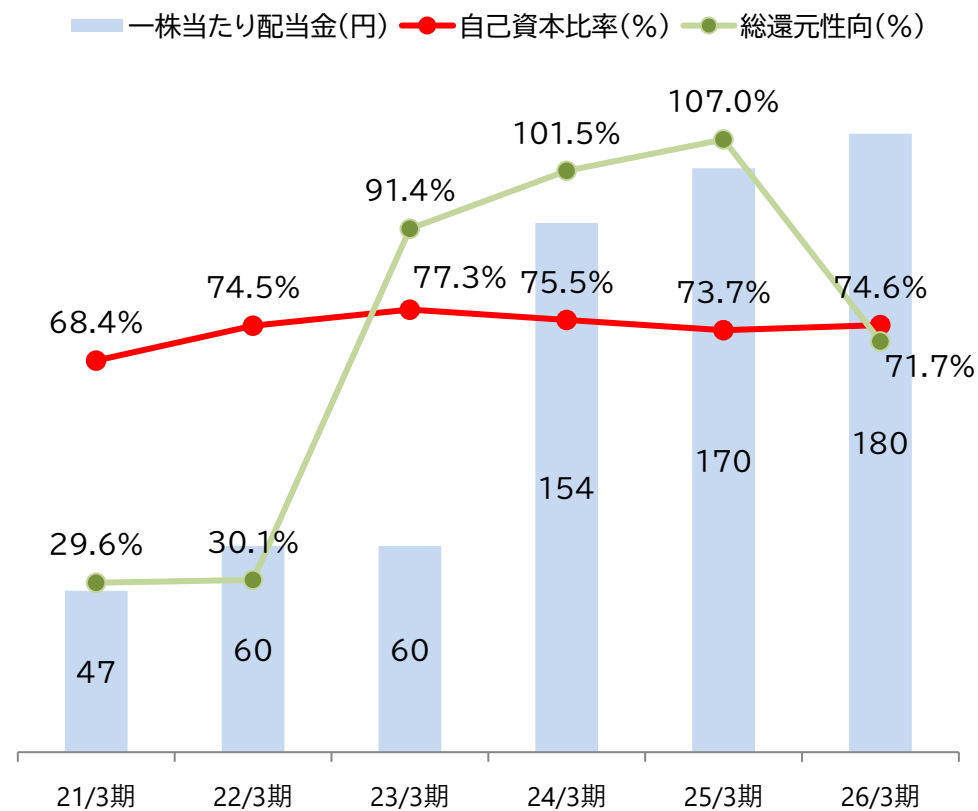
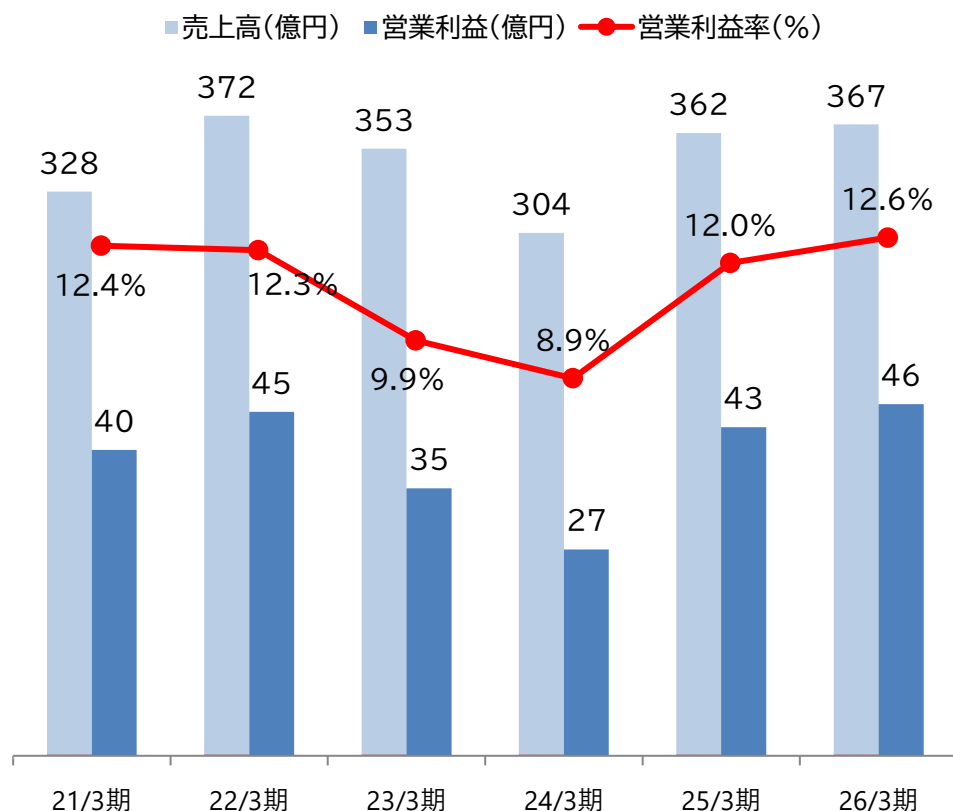
1. 現状分析

● 売上高・営業利益・営業利益率

2026年3月期においては、半導体、電子材料部門、運輸事業の売上増加により、利益水準・利益率ともに改善
トップラインの伸長と利益率の更なる改善が課題

● 配当金・自己資本比率・総還元性向

2024年3月期より総還元性向目標を100%に引き上げたことで、自己資本比率は低下トレンドへ転換
一方、2026年3月期は、記念配含め増配も、第三者割当による自己株式の処分を実施したことから自己資本
比率は上昇



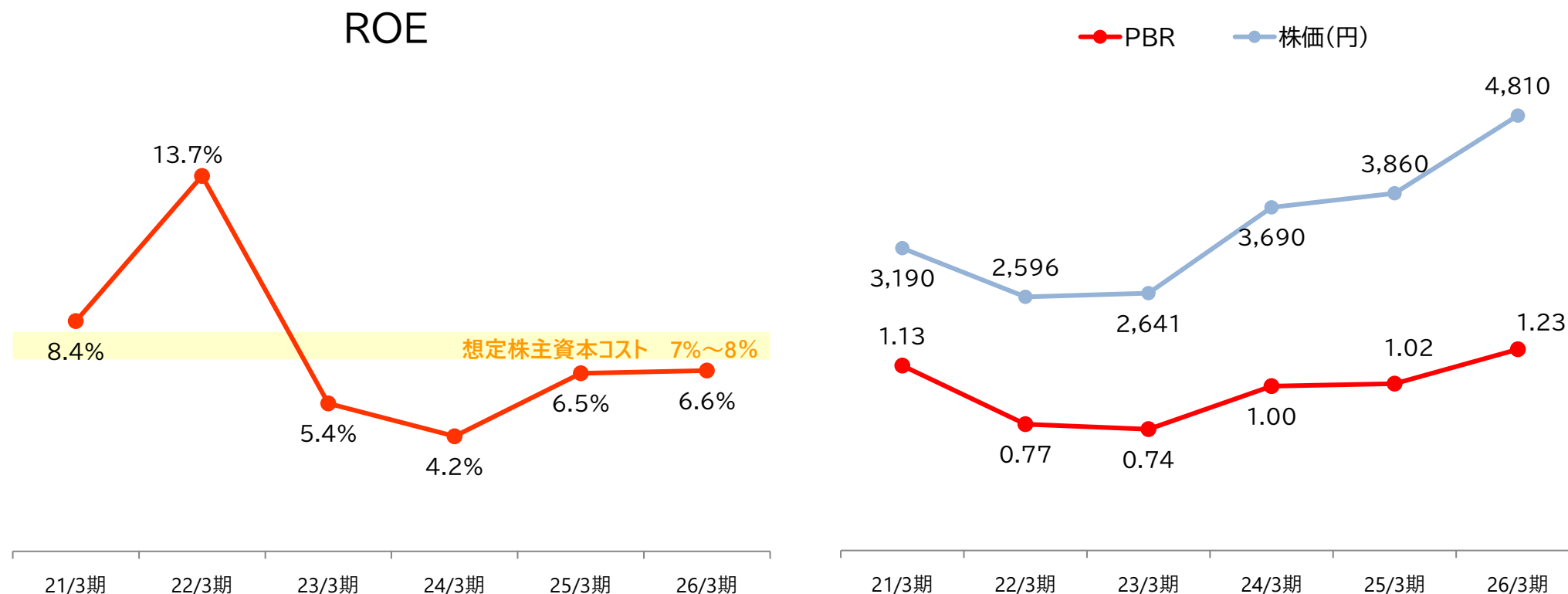
1. 現状分析

● ROE・株主資本コスト

2026年3月期は、増益によりROEは若干改善したものの、依然として想定株主資本コストを下回る水準で推移
第4次中期経営計画期間において、ROE8.0%以上の達成を目指す

● PBR・株価

総還元性向100%以上（第4次中期経営計画3年間累計）の株主還元実施や半導体分野をはじめとした事業拡大への期待等により株価が上昇し、PBRは、1.2倍付近まで上昇



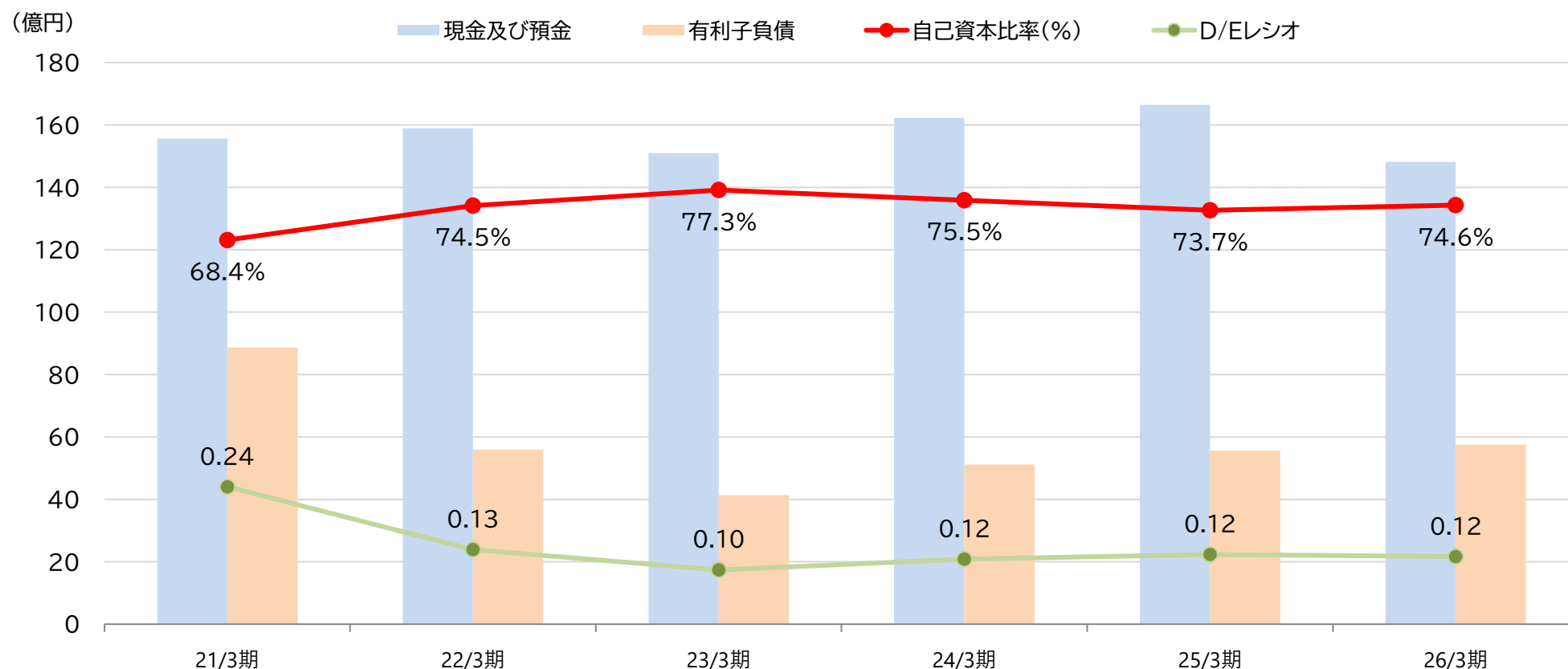
1. 現状分析

● 現預金

2026年3月期は減少に転じたものの、グループ資金の有効活用により更に削減の余地があると認識
第4次中期経営計画のキャッシュ・アロケーションを着実に実行して、残高圧縮を図る

● 有利子負債・D/Eレシオ

有利子負債は、若干増加したものの、自己資本の増加によりD/Eレシオは横ばい
第4次中期経営計画では、更に有利子負債の活用を進め、資本効率の改善を図る



2. 企業価値向上へ向けた取り組み方針

- ROEが依然として想定株主資本コストを下回っており、資本収益性の改善が優先課題と認識
- トップライン・利益率アップについては、半導体部門の販売力を強化し、粗利率の向上を図る
- 資本戦略では、自己資本の増加抑制に努め、中期的に目標とする資本構成に近づけていく
- 成長戦略では、半導体市場の急速な拡大を踏まえた新たな投資案件検討に着手



3. トップライン・利益率アップ：半導体部門における事業環境の変化

- AI需要の急速な拡大等を背景に、2025年後半頃から半導体メーカー各社の大幅に上方修正された投資計画が進行中であり、中計策定時の事業環境に大きな変化が見られる
- 2027年度後半以降に本格的な需要拡大が見込まれ、中期的に当社製品の需要増加が期待される

メーカー	主な生產品目	拠点	計画
マイクロン・テクノロジー	DRAM	アイダホ州(米国)	第1工場は2027年半ば、第2工場は2028年後半に生産開始予定
	DRAM	ニューヨーク州(米国)	最大4つの工場を建設予定
	DRAM	広島	新たなクリーンルームの建設着工、2028年後半に製造装置の搬入開始予定
	DRAM	台湾	PSMCの工場買収、AI用メモリ生産予定
	3D-NAND	シンガポール	新工場建設中、2028年後半に生産開始予定
キオクシア	3D-NAND	四日市・北上	2026～2028年度において年平均約4,700億円の投資を計画
TSMC	ロジック	熊本(第2工場)	2028年の設備搬入と量産開始を予定
Rapidus	ロジック	北海道	2027年度後半に2ナノ世代の半導体の量産を開始予定

(出所) 各種公表資料より当社作成



3. トップライン・利益率アップ：半導体部門の販売増加

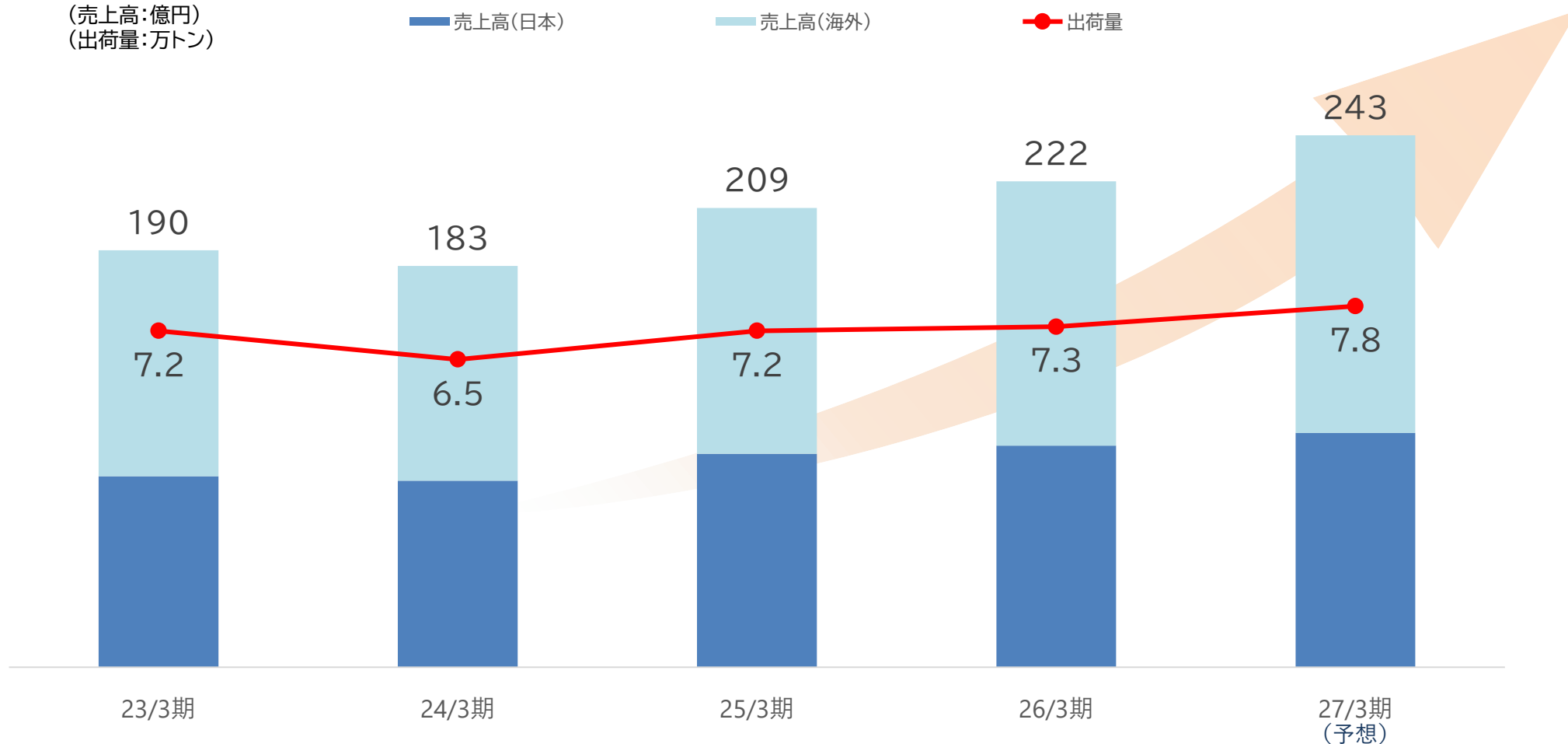
- 半導体部門の売上高は、需要の増加および価格転嫁の効果により増加傾向
- 特に海外のメモリーメーカー向けの出荷量増加により、2028年3月期以降も売上高の増加を見込む
- 高選択エッチング特性を持つ機能性薬液の評価も進展。差別化製品群による販売力を強化

(売上高:億円)
(出荷量:万トン)

■ 売上高(日本)

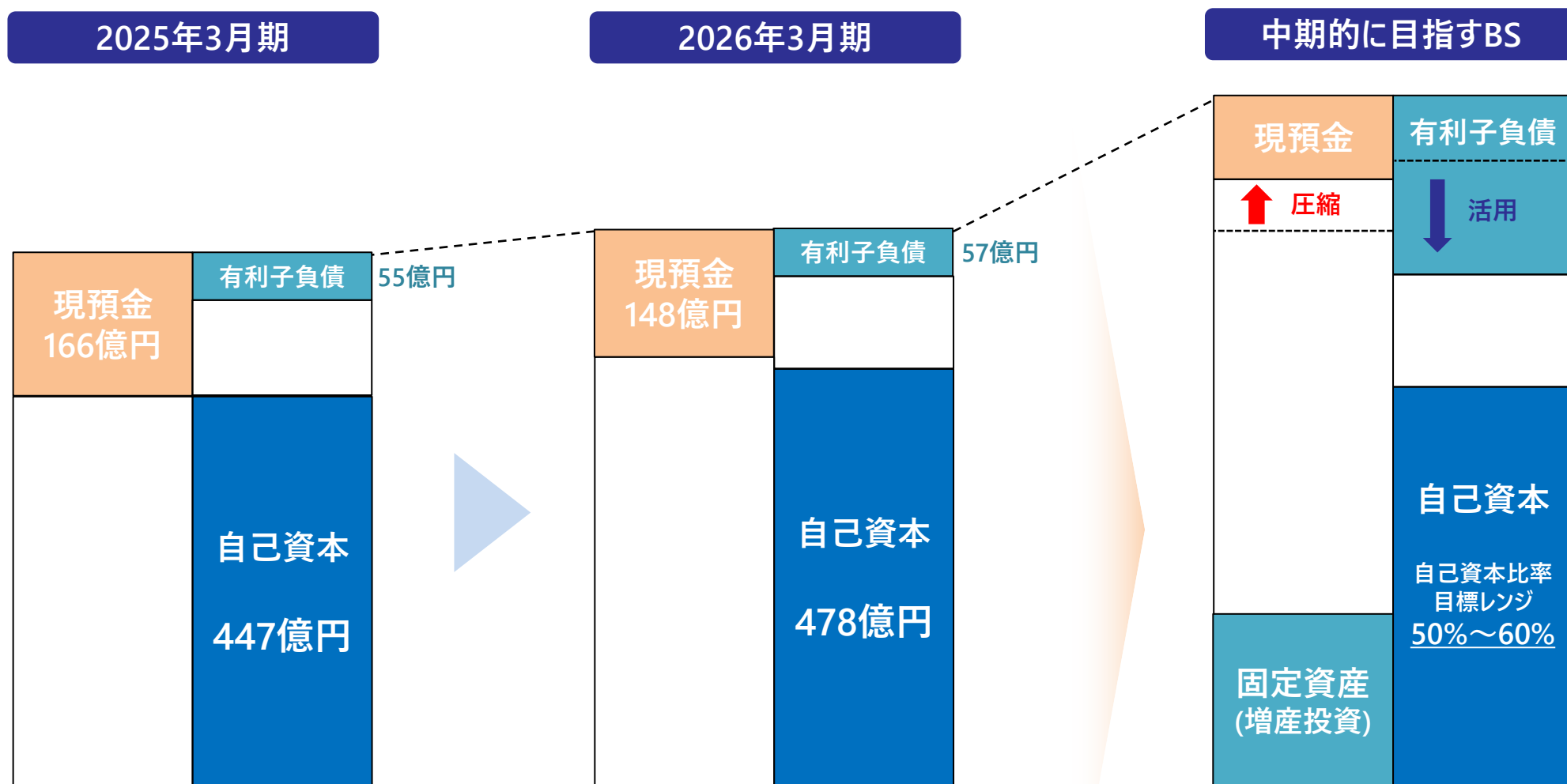
■ 売上高(海外)

● 出荷量



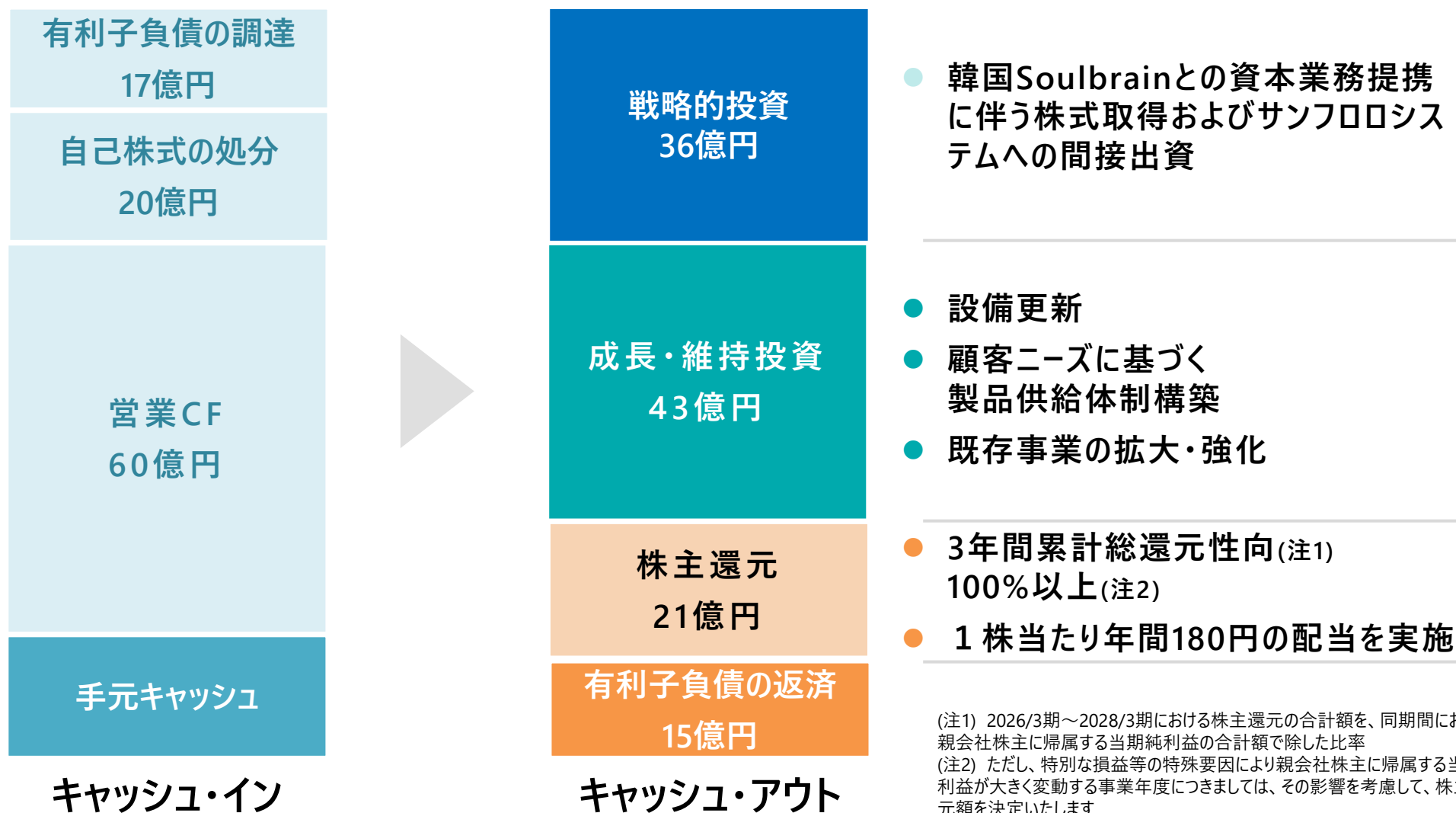
4. 財務・資本戦略：BSマネジメント

- 2026年3月期は、資本業務提携に伴う自己株式処分の実施および総還元性向が7割程度に留まったため、自己資本は増加
- 第4次中計での検討課題とした半導体関連の増産設備投資実行を前提に、最適資本構成算出アプローチにより設定した自己資本比率の目標レンジ（50%～60%）への収束を進める



4. 財務・資本戦略： キャッシュ・アロケーション (2026年3月期実績)

半導体関連を中心とした設備投資に加え、
配当による株主還元および資本業務提携に伴う戦略的投資を実施



5. IR・SR活動強化：情報開示と建設的な対話

定量・定性情報の開示強化および株主・投資家との対話機会の拡充を図り、情報非対称性の解消に努める

● 株主・投資家との対話の実施状況

面談実施状況（2026年3月期）

- ✓ 決算説明会：2回（期末・中間）
- ✓ 個別ミーティング（IR・SR） 83回

主な対応者

- ✓ 代表取締役社長・研究開発担当取締役
- ✓ 経理担当取締役・総務担当執行役員
- ✓ IR担当者

対話の主なテーマや関心事項

- ✓ 半導体市場見通し
- ✓ 第4次中期経営計画の成長戦略
- ✓ ROE向上施策
- ✓ 株主還元
- ✓ 最適な自己資本比率やD/Eレシオ
- ✓ 研究開発
- ✓ キャッシュ比率
- ✓ 社外取締役を主体とした任意の委員会運営

取 組 み

株主・投資家の皆様からいただいたご意見やご要望を取締役会にフィードバックするとともに、関係部門とも共有することで、経営やIR・SR活動の改善に反映

対話を踏まえた対応等

（実施内容）

- ✓ 総還元性向 3年間累計100%以上を目標（2026年3月期～2028年3月期）
- ✓ マテリアリティ、気候変動への対応の開示実施
- ✓ 資本市場・化学業界に精通した独立社外取締役の選任
- ✓ 指名報酬委員会において、委員長に独立社外取締役を選任

免責事項

本資料に掲載されている業績見通しに関する事項については、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、将来の業績を保証するものではなく、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

本資料に記載された内容は、事前の通知なくして変更されることがありますので、あらかじめご承知おきください。また掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関しましては、当社は一切の責任を負うものではありません。

本資料は、当社事業へのご理解をいただくために作成したものであります。

投資に関するご判断はご自身での責任で行われますようお願い申し上げます。